

Einladung



ZUM TRADITIONELLEN Forum Leiterplatte Schweiz

Wir freuen uns, Sie herzlich zum diesjährigen Forum Leiterplatte Schweiz einzuladen, unserem traditionellen Branchentreffen für Leiterplattenhersteller aus der DACH-Region.

Erleben Sie einen abwechslungsreichen Nachmittag mit spannenden Fachvorträgen, aktuellen Themen und anregenden Diskussionen.

Im Namen des Vorstands des Vereins Leiterplatte Schweiz wünschen wir allen Teilnehmenden eine interessante und inspirierende Veranstaltung, mit wertvollen Kontakten und neuen Impulsen im Kreise der Leiterplattenbranche aus der DACH-Region.

Datum: Dienstag, 30. September 2025

Beginn: 13:30h

Ort: Tagungszentrum Uediker-Huus
im Spilhöflier
CH-8142 Uitikon ZH
(Parkplätze sind genügend vorhanden)

Anmeldung: auf www.leiterplatteschweiz.ch oder QR-Code scannen:



Kosten: CHF 150.00 (Bargeldlose Zahlung bei Anmeldung oder vor Ort)

Programm

Moderator: Romeo Premierlani, Market Development Manager
bei Varioprint AG, CH-9410 Heiden; Vize-Präsident VLS

13:30 Uhr **Marktanalyse Europa (speziell D / A / CH)**
Remo Fischer, Betriebsleitung bei Hofstetter PCB AG, CH-6403 Küssnacht

13:45 Uhr **Herausforderungen und Vorgehensweise beim Benchmarking von Oberflächen für Drahtbondanwendungen**
Stefan Schmitz, CEO, Bond-IQ

Dieser Vortrag zeigt eine praxiserprobte Drahtbond-Benchmarking-Strategie, die neue Oberflächentechnologien systematisch gegen bewährte Referenzen testet. Von der Prozessfensterermittlung mittels statistischer Versuchsplanung über Schichthaftungsanalysen bis zur hochauflösenden FIB-REM-Charakterisierung – erfahren Sie, welche Prüfmethoden für ein Drahtbond-Benchmarking wirklich aussagekräftig sind und wie Sie kostspielige Fehlentscheidungen vermeiden. Anhand konkreter Messergebnisse und Fallbeispiele lernen Sie, die Bondbarkeit verschiedener Oberflächen quantitativ zu vergleichen und erkennen, welcher Aufwand hier investiert werden muss, wenn Sie Kunden eine „robuste und sichere“ Oberfläche anbieten wollen. Ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die in der Produktentwicklung und -beschaffung Weichen stellen und dabei auf Nummer sicher gehen wollen.

14:30 Uhr **Flexfiner and more**
Benjamin Rittreiser, Technical Sales Engineer Europe, Taiyo America

Es gibt verschiedene Lötstoppsysteme für flexible Leiterplatten. Neben der Möglichkeit ein Coverlay oder flexible konventionelle Lötstoppmasken aufzubringen, gibt es zusätzlich auch flexible Trockenfilmlötstoppsysteme. Im Zuge dessen möchte Taiyo das Flexfiner System vorstellen. Es handelt sich dabei um ein 2 Schicht System, das sich durch hohe Auflösung und Widerstandskraft auszeichnet.

15:15 Uhr ***Basismaterialien für Leiterplatten – Kupfer/Glas/Harz-Entwicklungen, REACH und Europäische Leiterplatten-Lieferkette***

Alexander Ippich, Technischer Direktor Signal Integrity and Advanced Technology, Isola Group

Um immer höheren Anforderungen an die Performance von Leiterplatten-Basismaterialien gerecht zu werden, sind nicht nur verbesserte Harzsysteme, sondern auch ‚high-end‘ Kupferfolien und Glasgewebe notwendig. Zusätzliche Anforderungen innerhalb der EU (REACH, SVHC Listen, PFAS) generieren weitere Einschränkungen und müssen bei der Material-Auswahl berücksichtigt werden. Geopolitische Konflikte machen eine Europäische Lieferkette immer wichtiger.

In diesem Vortrag soll auf diese Punkte eingegangen werden und eine Auswahl an geeigneten Materialien aufgezeigt werden.

16:00 Uhr ***Pause – Kaffeesponsor: Fa. Adeon Technologies B.V.***

16:45 Uhr ***Fähigkeiten und Herausforderungen beim Übergang von HDI zu Advanced HDI***

Lars-Eric Pribyl, Business Process Owner für „Product Management“ bei mks Atotech

Mit dem steigenden Bedarf an leistungsfähigeren und kompakteren Elektroniklösungen wird der Übergang von High-Density Interconnect (HDI) zu Advanced HDI in der Leiterplattenfertigung immer bedeutender. Diese Präsentation beleuchtet die sich entwickelnden Eigenschaften und die damit verbundenen Herausforderungen dieses Technologiewechsels. Im Fokus stehen die technischen Unterschiede und Prozessanforderungen fortschrittlicher Aufbauverfahren wie mSAP, amSAP und SAP. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Auswirkungen auf die chemische Kupferabscheidung, einschließlich zentraler Herausforderungen wie Palladium-Kurzschlüssen und Anforderungen an die Schichtdickenverteilung. Darüber hinaus werden wichtige Aspekte zur Zuverlässigkeit und Haftung in diesen komplexen Strukturen behandelt – für einen umfassenden Einblick in die Anforderungen der Advanced-HDI-Technologie.

17:30 Uhr ***Der Fluch des Fachkräftemangels – die Lösung erfordert Engagement Prüfung einer Hypothese***

Pascal Liske, Key Account Manager, easylearn schweiz ag

Pascal Liske, langjähriger Berater bei der easylearn schweiz ag, einem der führenden Schweizer Anbieter von Lernmanagement-Lösungen, greift in seinem Referat den Fachkräftemangel in der Leiterplattenindustrie auf. Beurteilen Sie gemeinsam mit dem Referenten die Hypothese, dass diesem Phänomen mittels effizienter Ausbildungsansätze für Quereinsteiger tatsächlich erfolgreich zu begegnen wäre. Können branchenspezifische E-Learning-Inhalte und effiziente Lernmanagement-Lösungen tatsächlich

Abhilfe schaffen? Wie könnte ein Szenario aussehen, in dem diese Hypothese im Praxistest validiert würde?

18:15 Uhr ***Schlusswort***

18:20 Uhr ***Apéro mit anschliessendem Nachtessen***
und gemütlichem Beisammensein